

评级：增持（维持）

分析师：王芳

执业证书编号：S0740521120002

Email: wangfang02@zts.com.cn

分析师：杨旭

执业证书编号：S0740521120001

Email: yangxu01@zts.com.cn

分析师：李雪峰

执业证书编号：S0740522080004

Email: lixf05@zts.com.cn

分析师：游凡

执业证书编号：S0740522120002

Email: youfan@zts.com.cn

基本状况

上市公司数	467
行业总市值(百万元)	6,149,322
行业流通市值(百万元)	2,965,011

行业-市场走势对比



相关报告

【中泰电子】半导体周跟踪：台积电预期谨慎板块回调，持续关注 Q1 高增公司

重点公司基本状况

简称	股价 (元)	EPS				PE				PEG (2024E)	评级
		2022A	2023A	2024E	2025E	2022	2023A	2024E	2025E		
寒武纪-U	175	-3.1	-2.0	-1.1	-0.4	-56	-86	-156	-429	-	NA
工业富联	23	1.0	1.1	1.3	1.5	23	22	18	15	1.1	买入
通富微电	23	0.3	0.1	0.6	0.8	69	206	38	27	0.5	NA
华勤技术	86	3.9	3.7	4.3	5.0	22	23	20	17	1.6	买入
沪电股份	31	0.7	0.8	1.3	1.6	44	39	25	20	0.7	买入
立讯精密	32	1.3	1.5	1.9	2.4	25	21	17	13	0.8	买入
兆易创新	83	3.1	0.2	1.5	2.4	27	344	55	35	0.7	买入
德明利	83	0.8	0.2	4.7	4.3	100	378	18	20	0.2	NA
香农芯创	35	0.7	0.8	1.0	1.1	46	42	35	31	2.3	买入

备注：股价采用 2024/5/31 收盘价，已覆盖公司采用我们预测值，未覆盖公司采用 Wind 一致预期。

投资要点

■ 市场整体回调，半导体指数逆市大涨 4.93%

本周（2024/5/27-2024/5/31）市场整体回调，沪深 300 指数跌 0.60%，上证综指跌 0.29%，深证成指跌 0.64%，创业板指数跌 0.74%，电子板块逆市上涨 2.73%，半导体指数大涨 4.93%。其中：SOC 涨 9.0%，其中中国科微（+38.7%）、富瀚微（+17.1%）、全志科技（13.9%）；晶圆代工涨 8.8%，其中燕东微（+10.5%）、中芯国际（+9.3%）、华虹公司（+6.0%）；存储涨 6.7%，其中万润股份（16.1%）、聚辰股份（11.9%）、恒硕股份（11.1%）；封测涨 6.3%，其中通富微电（+11.18%）、晶方科技（+8.82%）；材料涨 5.9%，其中容大感光（+32.97%）、强力新材（+16.25%）、晶瑞电材（+15.53%）；模拟涨 5.6%，其中上海贝岭（+39.7%）、富满微（+22.3%）、敏芯股份（+20.2%）；逻辑涨 5.2%，其中龙芯中科（+10.0%）、复旦微电（+8.9%）、景嘉微（+8.3%）；MCU 涨 4.9%，其中芯海科技（+11.6%）、峰昭科技（8.8%）；功率涨 4.4%，其中台基股份（+37.6%）、捷捷微电（+15.1%）；设备涨 2.3%，其中富乐德（+14.0%）、赛腾股份（+13.6%）、华峰测控（+13.2%）。

苹果于本周公布了 WWDC2024 全球开发者大会日程安排，预计 iOS 18 系统 Siri 升级、工具类 APP AI 以及接入 OpenAI 大模型是核心看点，重点关注苹果 AI 产业链；本周大基金三期正式注册成立，带动半导体板块逆市大涨，其中股价相对位置较低的标的表现较为突出，可继续关注低估值和股价相对低位标的。

本周我们发布了 2023 年报&2024 一季度总结暨策略报告，2024Q1 行业盈利拐点已现，我们认为 AI 仍是创新主线，持续推荐算力海外链、国产算力、存储及先进封装等相关方向。

■ 行业新闻

“大基金三期”正式成立

5 月 27 日消息，大基金三期已于 5 月 24 日注册成立，注册资本为 3440 亿元人民币。业内人士对第一财经记者表示，如果说国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，那么随着数字经济和人工智能的发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。此次大基金三期，除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将 HBM 等高附加值 DRAM 芯片列为重点投资对象。

苹果将于 6 月 11 至 15 日召开 WWDC2024 全球开发者大会

今年 WWDC2024 举办时间为北京时间 6 月 11-15 日，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间 6 月 11 日凌晨 1 点举行。按照往年惯例，重心将放在对新版系统的介绍中，预计苹果会在本次主题演讲中发布 iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS18、watchOS11 和 visionOS2，苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”，据路透社报道与 AI 功能有关。

美光投资 38-51 亿美元在日本新建 DRAM 芯片厂

美光近日宣布了一项重大投资计划，将在日本广岛县建设一座新的 DRAM 芯片制造工厂。根据日媒报导，这座新厂预计最快将于 2027 年底开始运营。新厂的总投资额预计在 6000 亿至 8000 亿日元（约合 38 至 51 亿美元）。

■ 重要公告

香农芯创：香农全资子公司联合创泰收到 AMD 发送的《经销商确认函》，同意联合创泰与 AMD 指定经销商进行采购。此前香农已是海力士大陆云服务存储最大代理商，已覆盖国内头部互联网和服务器厂商，此次成为 AMD 产品经销商，AMD 产品也将销售给现有客户。

彤程新材：公司发布公告，全资子公司上海彤程电子材料有限公司于 2024 年 5 月 27 日与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》，协议备案投资 3 亿元，项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫 25 万片、预计满产后年销售约 8 亿元。

甬矽电子：5 月 27 日，公司发布募集资金投向科技创新领域的说明公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 12 亿元，用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款。多维异构先进封装技术研发及产业化项目总投资额为 14.64 亿元，拟使用募集资金投资额为 9 亿元。

■ 投资建议：

AI 依然是 2024 年最强赛道，重点关注 AI 产业链机遇：

- (1) 苹果 AI 产业链：立讯精密，鹏鼎控股，水晶光电，歌尔股份，长盈精密，长电科技，领益智造，赛腾股份；
- (2) 算力海外链：沪电股份、工业富联、香农芯创等；
- (3) 国产算力：深南电路、寒武纪、海光信息等；
- (4) AI+：华勤技术、传音控股、大华股份、恒玄科技等；

存储：重点关注股价相对低位的设计公司，兆易创新、普冉股份、东芯股份和北京君正，同时持续关注存储全线产品涨价情况；

国产化产业链机会：

- (1) 设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、华海清科、芯源微、盛美上海、万业企业等；
- (2) 零部件：茂莱光学、福晶科技、波长光电、国力股份、富创精密、新莱应材等；
- (3) 材料：安集科技、鼎龙股份、路维光电、彤程新材、雅克科技；

低估值/股价相对低位：

力芯微、聚辰股份、恒硕股份、通富微电。

- 风险提示：需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

内容目录

1.行情回顾：市场整体回调，半导体指数逆市大涨 4.93%.....	- 5 -
1.1 海内外市场表现.....	- 5 -
1.2 A 股细分板块表现.....	- 6 -
1.3 沪、深股通总体增持半导体板块.....	- 8 -
2.行业新闻：大基金三期成立，苹果公布 WWDC 日程安排.....	- 9 -
3.板块跟踪：关注 AI 受益板块和国产化主题.....	- 10 -
4.重要公告：香农芯创确认成为 AMD 经销商.....	- 11 -
5.投资建议.....	- 12 -
6.风险提示.....	- 14 -

1.行情回顾：市场整体回调，半导体指数逆市大涨 4.93%

1.1 海内外市场表现

图表 1：海内外市场表现（2024/5/27-2024/5/31）

	指数名称	本周涨跌幅
A股指数	沪深300	-0.60%
	上证综指	-0.29%
	深证成指	-0.64%
	创业板指数	-0.74%
	中信电子	2.73%
	半导体指数	4.93%
海外指数	费城半导体	-1.87%
	台湾半导体	-3.82%

来源：wind，中泰证券研究所

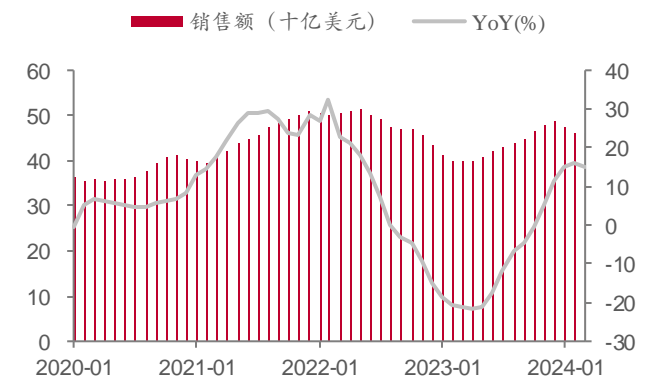
图表 2：费城半导体指数



来源：wind，中泰证券研究所

注：截至 2024 年 5 月 31 日

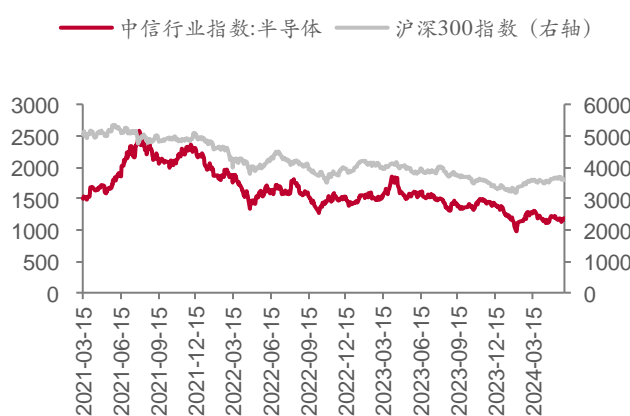
图表 3：全球半导体月度销售额及增速



来源：wind，中泰证券研究所

注：截至 2024 年 5 月 31 日

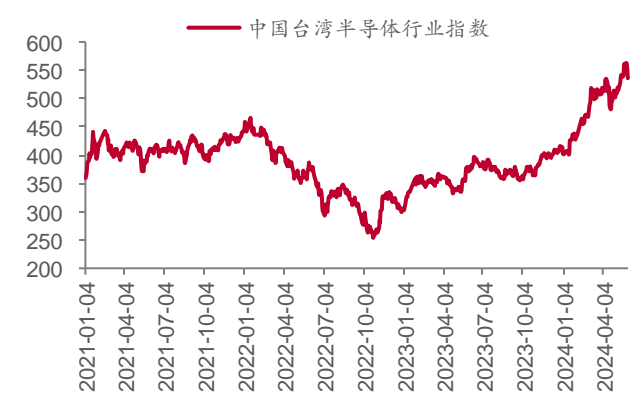
图表 4：A 股半导体指数



来源：wind，中泰证券研究所

注：截至 2024 年 5 月 31 日

图表 5：中国台湾半导体指数

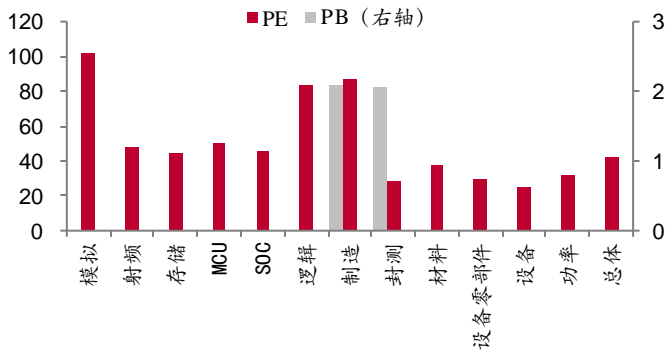


来源：wind，中泰证券研究所

注：截至 2024 年 5 月 31 日

1.2 A 股细分板块表现

图表 6：细分板块估值情况（2024E）

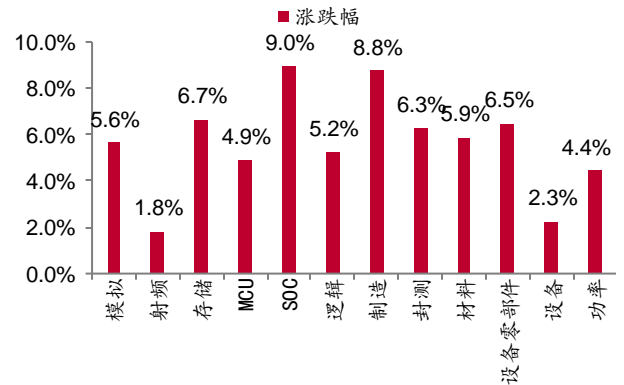


来源：wind，中泰证券研究所

注：PE=最近市值/2024 年 wind 一致预期净利润

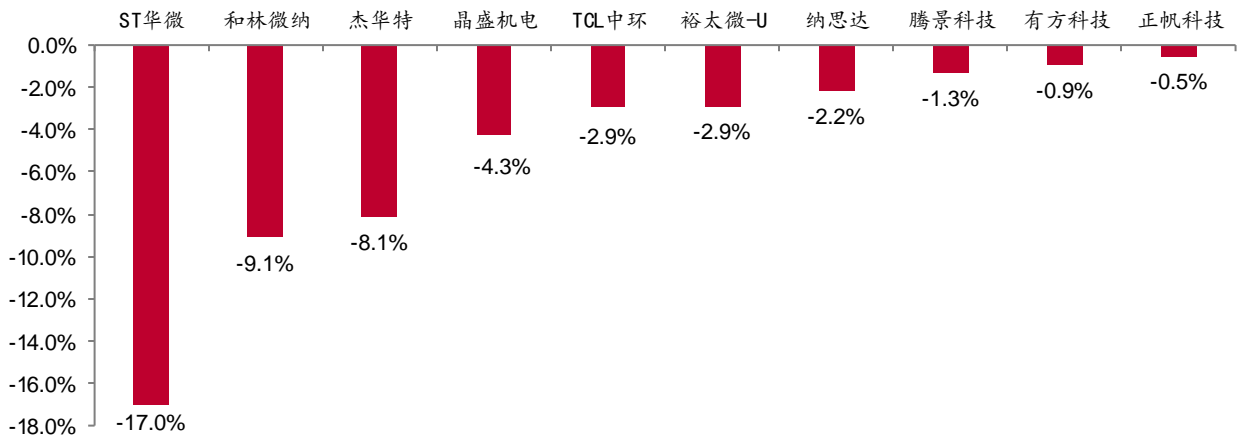
注：PB=最近市值/2024 年 wind 一致预期净资产

图表 7：本周半导体各细分板块涨跌幅情况



来源：wind，中泰证券研究所

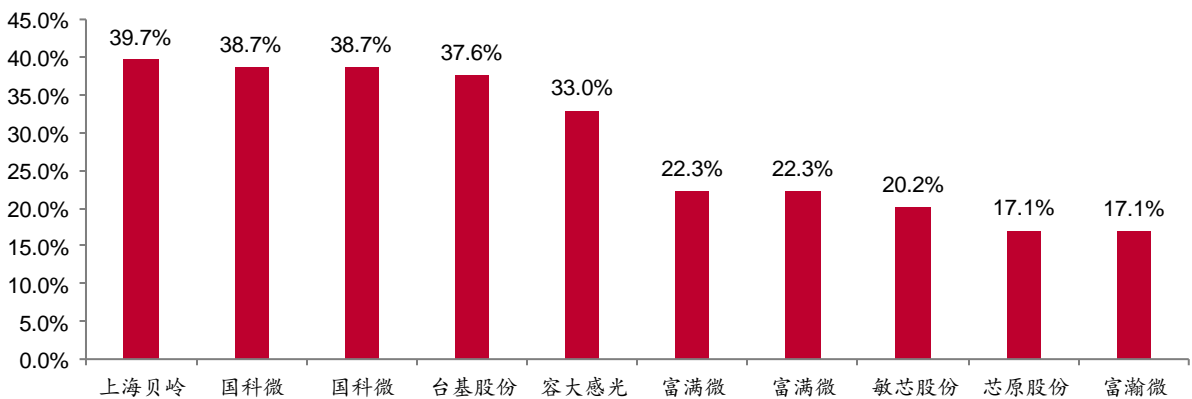
图表 8：本周半导体行业涨跌幅前十公司



来源：wind，中泰证券研究所

注：截至 2024 年 5 月 31 日

图表 9：本周半导体行业涨跌幅后十公司



来源：wind，中泰证券研究所

注：截至 2024 年 5 月 31 日

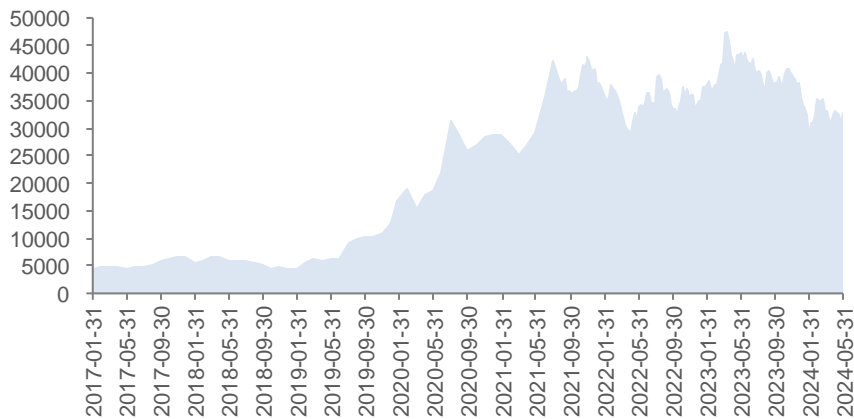
图表 10: A 股分板块公司总市值 (单位: 亿元)

板块	总市值	环比上周五涨跌幅
半导体	32748.6	5.6%
模拟	1992.4	5.6%
射频	698.9	1.8%
存储	3081.4	6.7%
MCU	811.8	4.9%
SOC	1489.3	9.0%
逻辑	4928.1	5.2%
制造	4920.9	8.8%
设备零部件	847.0	6.5%
设备	5331.6	2.3%
材料	3844.2	5.9%
封测	2015.5	6.3%
功率	2787.4	4.4%

来源: wind, 中泰证券研究所

注: 截至 2024 年 5 月 31 日

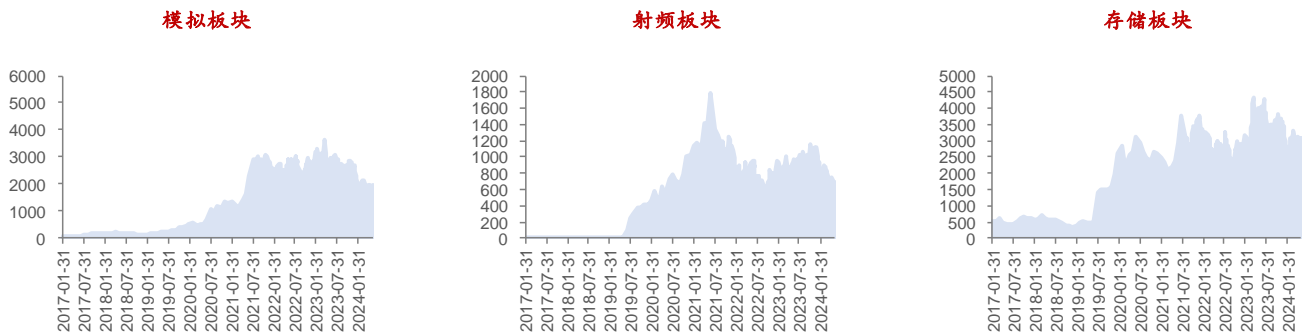
图表 11: A 股半导体板块公司总市值 (亿元)

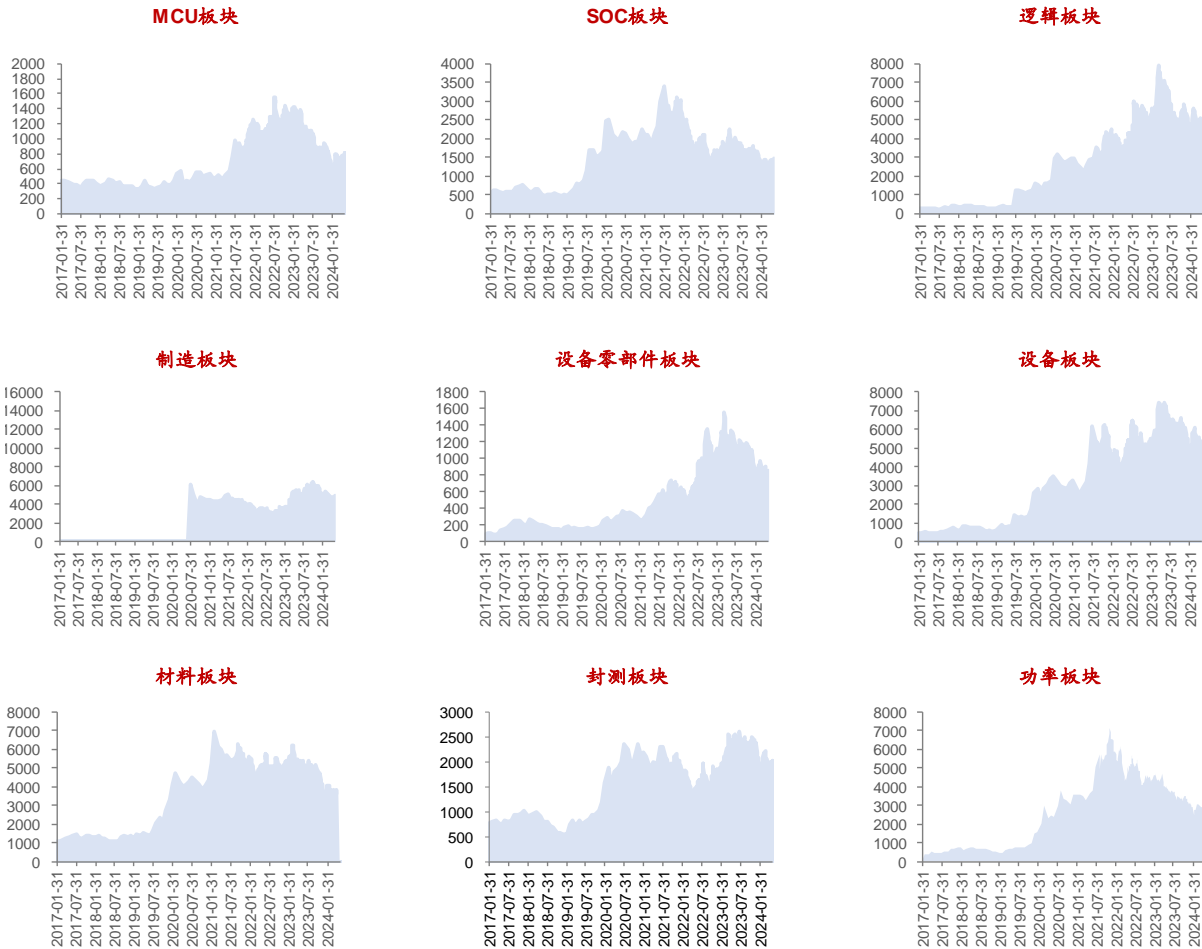


来源: wind, 中泰证券研究所

注: 截至 2024 年 5 月 31 日

图表 12: A 股各细分板块公司总市值 (亿元)





来源: wind, 中泰证券研究所

注: 截至 2024 年 5 月 31 日

1.3 沪、深股通总体增持半导体板块

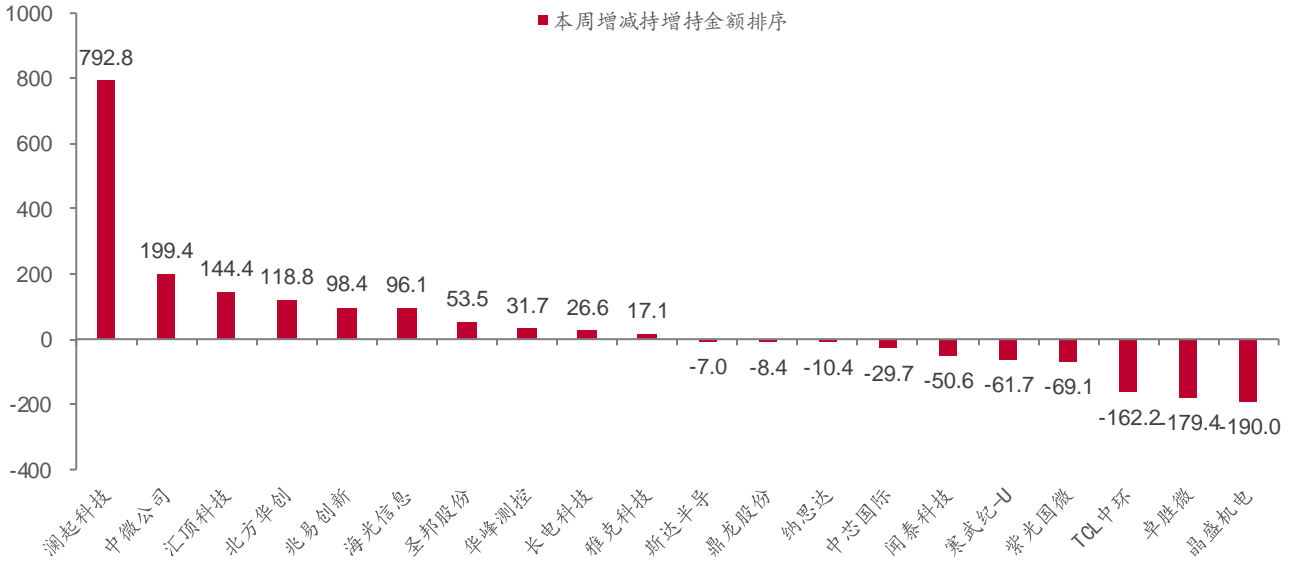
图表 13: 沪、深股通半导体板块持仓情况 (按持股市值排名)

本周排名	上周排名		证券代码	证券简称	一周增减持仓金额 (百万元)	一月增减持仓金额 (百万元)	年初至今增减持仓金额 (百万元)	沪(深)股通持股市值 (百万元)	沪(深)股通持股占自由流通股比例%
1	1	→	002371.SZ	北方华创	119	430	3,876	10,569	13.1
2	2	→	688012.SH	中微公司	199	-93	1,018	4,474	8.2
3	3	→	688008.SH	澜起科技	793	1,059	1,383	4,062	8.8
4	4	→	300782.SZ	卓胜微	-179	-324	-164	2,945	10.6
5	6	↑	603986.SH	兆易创新	98	-161	294	2,437	4.9
6	7	↑	688041.SH	海光信息	96	20	1,113	2,363	3.8
7	5	↓	300316.SZ	晶盛机电	-190	-383	-1,234	2,341	12.2
8	8	→	600584.SH	长电科技	27	-124	-310	2,268	6.7
9	9	→	002129.SZ	TCL中环	-162	-122	-1,204	1,790	5.6
10	12	↑	603160.SH	汇顶科技	144	303	-62	1,506	9.9
11	11	→	002409.SZ	雅克科技	17	-184	666	1,466	9.1
12	13	↑	300054.SZ	鼎龙股份	-8	107	295	1,333	9.0
13	10	↓	688256.SH	寒武纪-U	-62	-250	267	1,317	3.8
14	14	→	300661.SZ	圣邦股份	53	38	-13	1,259	5.7
15	17	↑	688200.SH	华峰测控	32	-48	417	1,141	13.7
16	16	→	600745.SH	闻泰科技	-51	-69	29	1,128	4.6
17	18	↑	688981.SH	中芯国际	-30	-111	828	1,117	1.6
18	19	↑	002049.SZ	紫光国微	-69	-421	19	999	2.9
19	15	↓	603290.SH	斯达半导	-7	-98	172	943	9.9
20	20	→	002180.SZ	纳思达	-10	-40	-126	840	3.4

来源: wind, 中泰证券研究所

注: 此表中沪(深)股通持股市值=沪(深)股通持股数量*上周交易均价, 数据更新截止于 2024/5/31;

图表 14: 沪、深股通半导体板块本周增减持金额 (沪/深股通持股市值前 20 公司) (单位: 百万元)



来源: wind, 中泰证券研究所

注: 截至 2024 年 5 月 31 日

2.行业新闻: 大基金三期成立, 苹果公布 WWDC 日程安排

■ “大基金三期”正式成立

5月27日消息,据国家企业信用信息公示系统,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大下称“大基金三期”)已于5月24日注册成立,系统信息显示,国家大基金三期注册资本为3440亿元人民币。业内人士对第一财经记者表示,如果说国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域,那么随着数字经济和人工智能的发展,算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。此次大基金三期,除了延续对半导体设备和材料的支持外,更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。

链接: <https://mp.weixin.qq.com/s/p04um71zJGEMgZf3e7HJIQ>

■ 苹果将于6月11日至15日召开 WWDC2024 全球开发者大会

今年 WWDC2024 的举办时间为太平洋时间 6 月 10 日至 14 日(北京时间 6 月 11-15 日),最为瞩目的主题演讲将在北京时间 6 月 11 日凌晨 1 点举行。按照往年惯例重心将放在对新版系统的介绍,预计苹果会在本次主题演讲中发布 iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS18、watchOS11 和 visionOS2,苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”,据路透社的报道,苹果的大招与 AI 功能有关。

链接: https://mp.weixin.qq.com/s/9X5jaBJXMSLqT_j7N18-ZA

■ 美光投资 38-51 亿美元在日本新建 DRAM 芯片厂

美光近日宣布了一项重大投资计划,将在日本广岛县建设一座新的

DRAM 芯片制造工厂。根据日媒报导，这座新厂预计最快将于 2027 年底开始运营。新厂的总投资额预计在 6000 亿至 8000 亿日元（约合 38 至 51 亿美元）。

链接:

<https://m.chinaflashmarket.com/news/industry/181613?app=article×tamp=1717155901>

■ 维信诺计划投资 550 亿建设 8.6 代 AMOLED 生产线

5 月 28 日午间公告，维信诺与合肥市政府签署《投资合作备忘录》，计划投资 550 亿建设 8.6 代 AMOLED 生产线，设计产能为每月 32,000 片。这一举措不仅展现了中国在 OLED 领域的雄心，也预示着 OLED 技术在中大尺寸市场的快速渗透和增长。

链接: <https://mp.weixin.qq.com/s/NnjJxLPfzukLljVOM5z7aA>

3. 板块跟踪：关注 AI 受益板块和国产化主题

- **模拟**: 本周模拟 IC 板块涨 5.6%，上海贝岭(+39.7%)、富满微(+22.3%)、敏芯股份(+20.2%) 涨幅靠前。国内模拟芯片行业初创公司出清明显，一季度主要上市公司毛利率整体回升，基本面整体呈现边际向好态势，前期经历调整后，部分公司配置性价比逐渐显现，关注其中低估值标的和低国产化率的细分赛道。
- **存储**: 本周板块涨 6.7%，涨幅前三分别为万润股份、聚辰股份、恒烁股份，股价上涨 16%、12%、11%。存储板块周期+国产化+AI 创新三重逻辑，利基存储价格趋势凸显，持续关注大陆存储设计公司后续涨价节奏和盈利修复。
- **功率**: 本周功率板块+4.4%。其中台基股份(+37.6%)、捷捷微电(+15.1%) 涨幅居前。近期市场关注变压器出海，变压器中核心的功率器件为晶闸管、IGCT。捷捷微电和台基股份为我国晶闸管龙头厂家，股价受益于变压器主题。富满微则跟随 MCU 板块大涨。本周功率跟随半导体板块整体一起，受到大基金三期新闻提振，情绪面改善。
- **碳化硅**: 本周碳化硅板块-0.08%。其中晶升股份(+6.1%)、天岳先进(+3.2%)、三安光电(+1.3%)、东尼电子(+1.2%)、晶盛机电(-4.3%)。本周碳化硅板块跟随半导体板块整体一起，受到大基金三期新闻提振，情绪面改善。
- **设备**: 本周设备板块+2.3%。其中富乐德(+14.0%)、赛腾股份(+13.6%)、华峰测控(+13.2%) 涨幅居前。富乐德上涨主要系大基金三期新闻利好其大客户中芯国际；赛腾股份大客户苹果本周的 AI 主题受市场关注；华峰测控受益于下游封测景气改善预期。设备板块整体，则受益于本周大基金三期新闻利好催化。
- **代工**: 本周代工板块+8.8%。其中燕东微(+10.5%)、中芯国际(+9.3%)、华虹公司(+6.0%)、晶合集成(+3.2%)、芯联集成(+0.5%)。本周大基金三期新闻发布，此次注册资本达 3440 亿元，规模超出市场预期。从资金承载力看，晶圆制造板块的研发和投资规模大于其他半导体板块，最有望充分受益于大基金三期后期的投资。
- **封测**: 本周封测板块+6.3%。其中通富微电(+11.18%)、晶方科技

(+8.82%)、华岭股份(+8.37%)、蓝箭电子(+7.76%)涨幅居前,其余长电科技(+5.87%)、甬矽电子(+3.44%)、华天科技(+2.00%)。从历史看,封测 Q2 景气通常好于 Q1。市场预期封测 Q2 景气边际好转,叠加此前股价回调,布局性价比较高,本周整体股价迎来上涨。

- **材料:** 本周半导体材料板块+4.9%,其中容大感光(+32.97%)、强力新材(+16.25%)、晶瑞电材(+15.53%),本周材料涨幅较大主要系大基金三期落地,带动市场对半导体关键设备、材料国产化的关注。目前上游的先进封装、先进制程材国产化率极低,同时是实现产业链自主可控的关键,随着产业链公司前期验证的产品逐步实现放量,基本面向好,相关公司具备持续成长动力,持续看好材料端的国产化主线。
- **逻辑:** 本周逻辑 IC 板块+5.2%,其中龙芯中科(+10.0%)、复旦微电(+8.9%)、景嘉微(+8.3%)涨幅靠前。本周 AI PC 产业链表现相对强势,催化 PC 相关标的股价反弹。长线来看,我们看好 AI 长期投资方向,算力是人工智能产业的底层土壤,持续看好海外算力产业链创新及国产算力公司替代机遇。
- **SOC:** 本周 SoC 板块+9.0%,其中中国科微(+38.7%)、富瀚微(+17.1%)、全志科技(13.9%)。本周股价位置相对底部公司反弹明显,国科微、博通集成领跑板块涨幅。从基本面看,SoC 历经两年调整,产品价格、渠道库存修复正常,需求逐步边际向好。目前板块处于底部区间,Q1 业绩拐点明显,建议关注 Q2 需求持续高增,叠加新品创新周期方向。

4.重要公告: 香农芯创确认成为 AMD 经销商

- **香农芯创:** 香农全资子公司联合创泰收到 AMD 发送的《经销商确认函》,同意联合创泰与 AMD 指定经销商进行采购。此前香农已是海力士大陆云服务存储最大代理商,已覆盖国内头部互联网和服务器厂商,此次成为 AMD 产品经销商,AMD 产品也将销售给现有客户。算力和存力是 AI 硬件基础,公司代理的海力士存储、经销的 AMD 处理器,均代表了全球最先进的存力和算力,公司覆盖的互联网和服务器客户是大陆 AI 硬件最大需求方,公司卡位唯稀缺,将深度受益 AI 浪潮。
- **彤程新材:** 公司发布公告,全资子公司上海彤程电子材料有限公司于 2024 年 5 月 27 日与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》,协议备案投资 3 亿元,项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫 25 万片、预计满产后年销售约 8 亿元。
- **甬矽电子:** 5 月 27 日,公司发布募集资金投向科技创新领域的说明公告,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 12 亿元,用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款。多维异构先进封装技术研发及产业化项目总投资额为 14.64 亿元,拟使用募集资金投资额为 9 亿元。实施地点位于公司浙江宁波的二期工厂,届时将购置临时健合设备、机械研磨设备、化学研磨机、干法刻硅机、化学气相沉积机、晶圆级模压机、倒装贴片机、助焊剂清洗机、全自动磨片机等先进的研发试验及封测生产设备。项目建成后,甬矽电子将开展“晶圆级重构封装技术(RWL P)”、“多层布线连接技术(HCOS-OR)”、“高铜柱连接技术(HCOS-OT)”、“硅通

孔连接板技术 (HCOS-SI) ”和“硅通孔连接板技术 (HCOS-AI) ”等方向的研发及产业化,并在完全达产后形成年封测扇外型封装 (Fan-out) 系列和 2.5D/3D 系列等多维异构先进封装产品 9 万片的生产能力。

- **微导纳米:** 5 月 29 日, 公司发布募集资金投向科技创新领域的说明公告, 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 11.7 亿元, 扣除发行费用后募集资金净额将用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目、补充流动资金。半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目总投资额为 6.7 亿元, 拟使用本次募集资金金额约 6.43 亿元。计划建设先进的生产车间, 购置先进生产设备和量测设备, 提升公司薄膜沉积设备的生产能力。本项目主要生产半导体领域 iTomic 系列和 iTronix 系列产品, 其涉及原子层沉积和化学气相沉积两大类设备。通过本项目的建设, 公司将持续拓展半导体领域产品的工艺技术类型, 并对现有 iTomic 系列和 iTronix 系列产品进行技术升级, 延展机台的工艺范围, 同时在设备的占地、产能、成本上进行优化, 开发并量产更加先进的工艺技术。
- **捷捷微电:** 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买捷捷南通科技 30.24% 股权。公司向苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦购买其合计持有的捷捷南通科技 30.24% 股权, 其中以发行股份、现金方式支付对价的比例占交易对价的比例分别为 65.00%、35.00%。本次交易完成后, 上市公司将持有捷捷南通科技 91.55% 股权。上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金, 本次募集配套资金总额不超过 66,000 万元 (含 66,000 万元), 不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%, 且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本 30%。

5. 投资建议

- **AI 依然是 2024 年最强赛道, 重点关注 AI 产业链机遇:**
 - (1) 苹果 AI 产业链: 立讯精密, 鹏鼎控股, 水晶光电, 歌尔股份, 长盈精密, 长电科技, 领益智造, 赛腾股份;
 - (2) 算力海外链: 沪电股份、工业富联、香农芯创等;
 - (3) 国产算力: 深南电路、寒武纪、海光信息等;
 - (4) AI+: 华勤技术、传音控股、大华股份、恒玄科技等;
- **存储: 重点关注股价相对低位的设计公司: 兆易创新、普冉股份、东芯股份和北京君正, 同时持续关注存储全线产品涨价情况;**
- **国产化产业链机会:**
 - (1) 设备: 北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、华海清科、芯源微、盛美上海、万业企业等;
 - (2) 零部件: 茂莱光学、福晶科技、波长光电、国力股份、富创精密、新莱应材等;
 - (3) 材料: 安集科技、鼎龙股份、路维光电、彤程新材、雅克科技;
- **低估值/股价相对低位: 力芯微、聚辰股份、恒硕股份、通富微电。**

图表 15: 盈利预测与财务指标

代码	重点公司	现价		EPS			PE			评级
		2024/5/31	2023A	2024E	2025E	2023A	2024E	2025E		
603501.SH	韦尔股份	94	0.5	2.9	4.0	206	33	24	买入	
603986.SH	兆易创新	83	0.2	1.5	2.4	344	55	35	买入	
300327.SZ	中颖电子	22	0.5	0.5	1.0	41	42	22	买入	
688595.SH	芯海科技	31	-1.0	-0.3	0.3	-31	-102	94	NA	
300661.SZ	圣邦股份	78	0.6	0.7	1.5	130	109	53	买入	
688173.SH	希荻微	11	-0.1	-0.4	-0.1	-86	-30	-126	买入	
688536.SH	思瑞浦	95	-0.3	1.4	2.7	-362	67	36	NA	
300782.SZ	卓胜微	87	2.1	2.6	3.3	41	34	26	NA	
600460.SH	士兰微	19	0.0	0.2	0.3	-874	101	60	买入	
300373.SZ	扬杰科技	36	1.7	2.0	2.8	21	18	13	买入	
603290.SH	斯达半导	87	5.3	4.3	5.3	16	21	16	买入	
688711.SH	宏微科技	24	0.8	1.0	1.4	31	24	17	买入	
605358.SH	立昂微	21	0.1	0.4	0.7	219	56	30	NA	
300666.SZ	江丰电子	47	1.0	1.1	1.5	48	42	30	买入	
688126.SH	沪硅产业	14	0.1	0.1	0.1	199	152	107	NA	
002436.SZ	兴森科技	12	0.1	0.2	0.3	95	65	39	买入	
002409.SZ	雅克科技	59	1.2	2.1	2.8	49	28	21	NA	
300054.SZ	鼎龙股份	22	0.2	0.5	0.7	96	48	34	NA	
688019.SH	安集科技	157	4.1	4.9	6.3	39	32	25	NA	
688268.SH	华特气体	51	1.4	1.9	2.6	36	26	20	NA	
688106.SH	金宏气体	18	0.6	0.8	1.0	28	22	17	买入	
002371.SZ	北方华创	293	7.4	10.2	13.5	40	29	22	买入	
688037.SH	芯源微	93	1.8	2.5	3.6	51	37	26	买入	
688200.SH	华峰测控	112	1.9	3.0	3.7	60	38	30	买入	
688012.SH	中微公司	130	2.9	3.4	4.3	45	38	30	买入	
688630.SH	芯碁微装	65	1.4	2.0	2.9	47	32	22	NA	
688981.SH	中芯国际	45	0.6	0.5	0.7	74	87	67	NA	
688347.SH	华虹公司	34	1.1	1.1	1.3	30	30	26	NA	
600584.SH	长电科技	26	0.8	1.5	2.1	32	18	12	买入	
603005.SH	晶方科技	19	0.2	0.5	0.6	81	41	30	NA	
002156.SZ	通富微电	23	0.1	0.6	0.8	206	38	27	NA	
000021.SZ	深科技	13	0.4	0.6	0.8	32	22	17	NA	
002185.SZ	华天科技	8	0.1	0.2	0.3	116	45	27	NA	
688385.SH	复旦微电	31	0.9	1.0	1.2	36	32	26	买入	
688107.SH	安路科技	24	-0.5	-0.2	-0.1	-48	-97	-423	NA	
603893.SH	瑞芯微	57	0.3	0.8	1.3	177	69	44	买入	
688008.SH	澜起科技	53	0.4	1.2	1.9	134	45	28	NA	
688099.SH	晶晨股份	58	1.2	1.7	2.4	49	34	25	买入	
688256.SH	寒武纪-U	175	-2.0	-1.1	-0.4	-86	-156	-429	NA	
002463.SZ	沪电股份	31	0.8	1.3	1.6	39	25	20	买入	
001309.SZ	德明利	83	0.2	4.7	4.3	378	18	20	NA	

300475.SZ	香农芯创	35	0.8	1.0	1.1	42	35	31	买入
-----------	------	----	-----	-----	-----	----	----	----	----

来源：wind，中泰证券研究所

注：未覆盖公司采用 Wind 一致预期，已覆盖公司采用预测数据

6.风险提示

- 需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

投资评级说明:

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

重要声明:

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。